

# DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み :
  - デバイス温度 : 電气的性能のため -40 ~ 115°C の動作時周囲温度範囲を規定
- 7.55Gbps (6Gbps ビデオ ペイロード) は 8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサに対応
- Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
- 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
  - MIPI D-PHY v2.1 準拠
  - 1 つのクロック レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ レーン
  - レーンあたり最大 1.5Gbps、ポートあたり最大 6Gbps
  - 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
  - 16 の仮想チャネル
- シングルポート MIPI CSI-2 レシーバ
  - MIPI CSI-2 v2.1 準拠
  - 複数のデータ タイプとマルチ エクスポートをサポート
- CRC データ保護、センサ データ完全性チェック、I2C 書き込み保護、電圧/温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断
- 柔軟なプログラマブル出力カロック ジェネレータ
- シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり、
- 1.8V の単一電源
- DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 デシリアライザと互換
- DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザと互換
- 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト センサ モジュール設計向けのソリューション サイズ

## 2 アプリケーション

- 先進運転支援システム (ADAS)
  - サラウンド ビュー システム (SVS)
  - カメラ監視システム (CMS)
  - 前方視野カメラ (FC)
  - ドライバー監視システム (DMS)
  - リアビュー カメラ (RVC)
  - 車載用衛星レーダーおよび LIDAR モジュール
  - タイム オブ フライト (ToF) センサ
- セキュリティおよび監視カメラ
- 産業用および医療用イメージング

## 3 概要

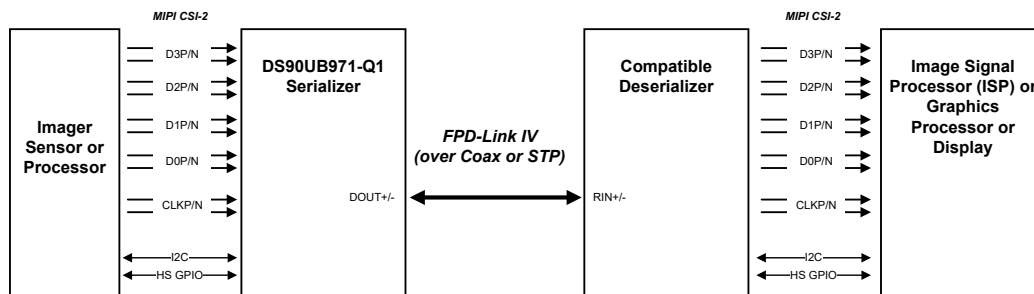
DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速ロー データ センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、7.55Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB971-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および車載機能安全をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB971-Q1 は高精度のマルチカメラ センサクロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB971-Q1 は、AEC-Q100 認定済みであり、-40°C ~ 115°C までの広い温度範囲に対応しています。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサアプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

### 製品情報

部品番号	パッケージ (1)	本体サイズ (公称)
DS90UB971-Q1	VQFN (32)	5.00mm × 5.00mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



### 代表的なアプリケーション



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

## 4 Device and Documentation Support

### 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[\[通知\]](#) をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 4.2 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 4.3 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.  
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 4.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 4.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 5 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
DS90UB971RHRQ1	ACTIVE	VQFN	RHB	32	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q	Samples
DS90UB971RHBTQ1	ACTIVE	VQFN	RHB	32	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	367.0	367.0	35.0
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	210.0	185.0	35.0

## GENERIC PACKAGE VIEW

**RHB 32**

**VQFN - 1 mm max height**

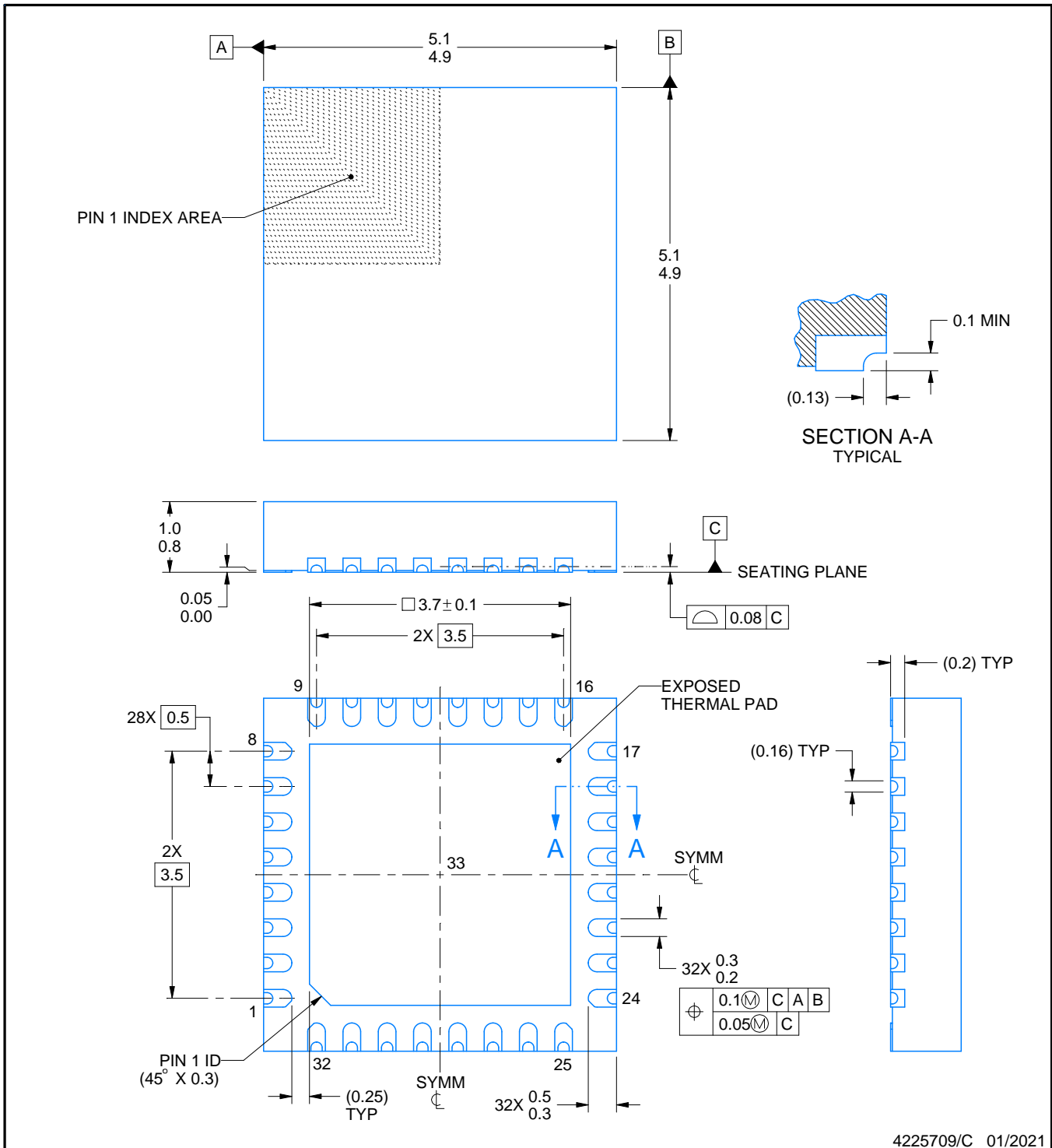
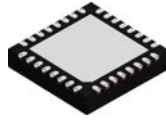
5 x 5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

4224745/A



4225709/C 01/2021

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

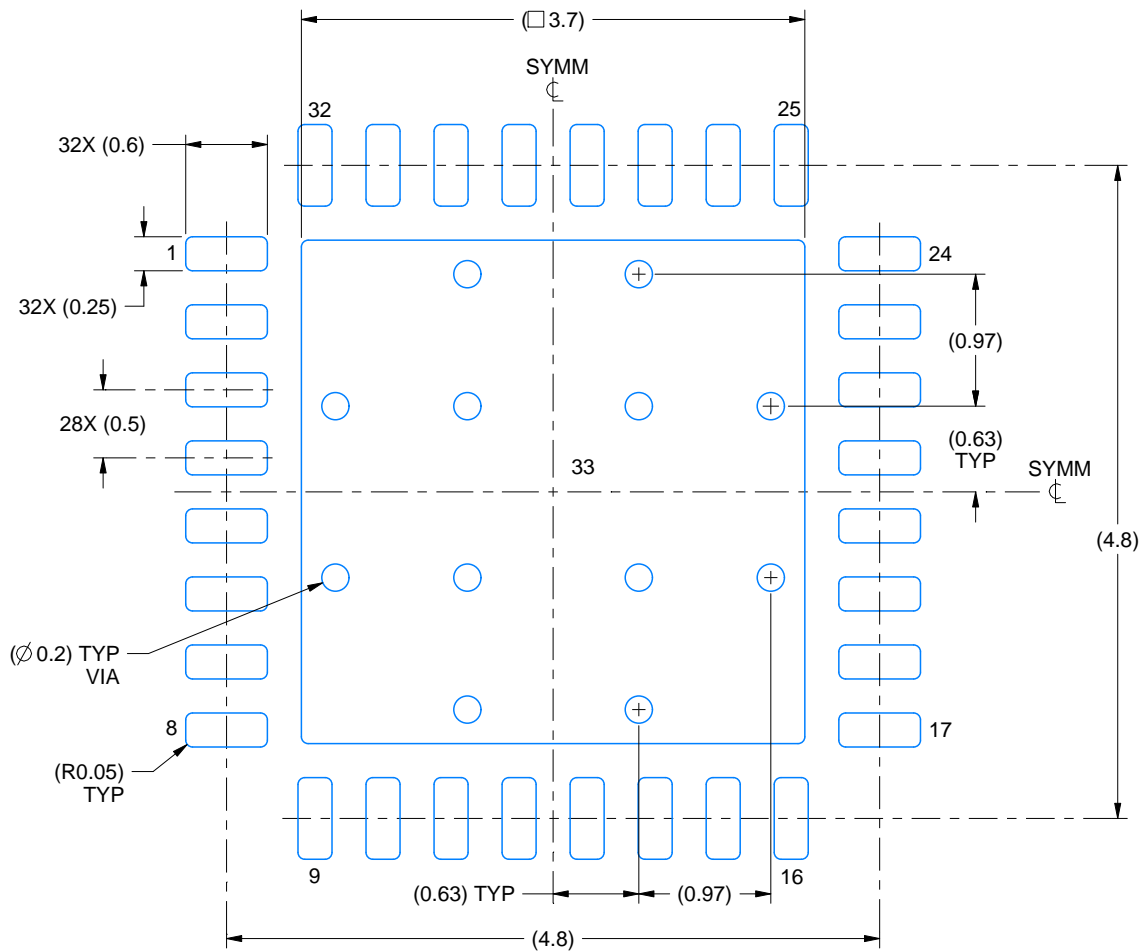


# EXAMPLE BOARD LAYOUT

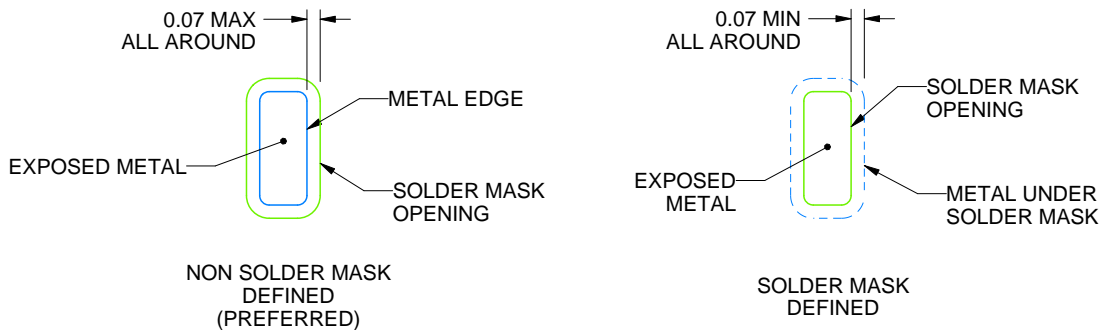
RHB0032U

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:18X



SOLDER MASK DETAILS

4225709/C 01/2021

NOTES: (continued)

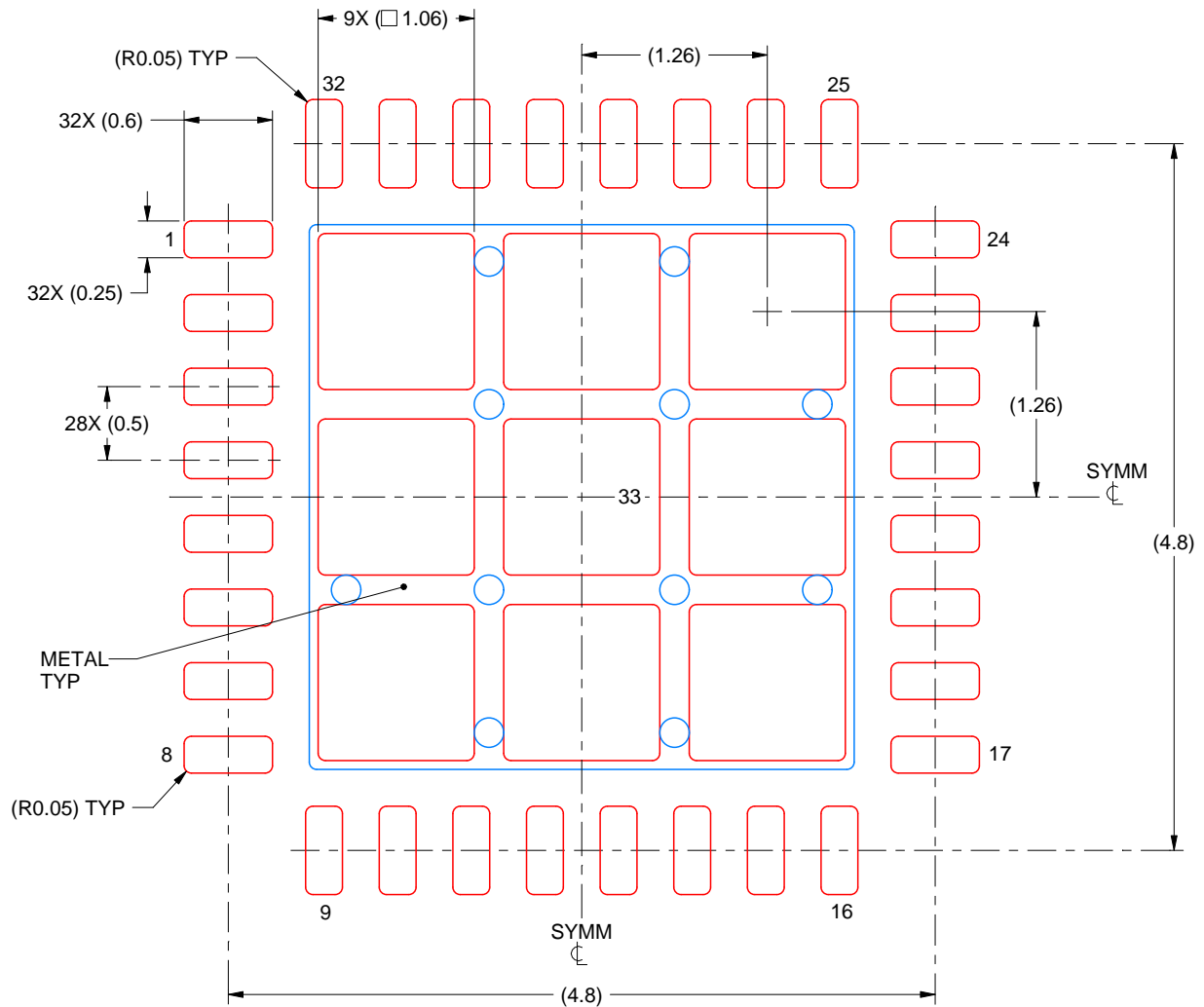
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/slua271](http://www.ti.com/lit/slua271)).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

RHB0032U

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



**SOLDER PASTE EXAMPLE**  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 33:  
74% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE  
SCALE:20X

4225709/C 01/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated